



锡膏使用注意事项

TAMURA KAKEN (DONGGUAN) LTD.



● 錫膏的保管

1. 為防止助焊劑和焊錫粉化學反應的促進, 請放置于0~10℃的陰暗場所(冷藏庫)密封保管, 保管期限為制造日期起6個月.
2. 為了防止冷凝水分進入錫膏容器內, 從冷藏庫內取出後, 溫度回至室溫後再進行開封.
3. 未開封錫膏在室溫25℃, 濕度40-60%, 密封放置建議不超過72小時.
4. 開封後使用之錫膏(室溫25℃, 濕度40-60%)建議於24小時內用完.
5. 錫膏印刷完後建議在6小時內完成回流焊接.



● 回溫及攪拌

1. 錫膏從冰箱取出開封前須放置在室溫 (25℃) 回溫3~4個小時。(禁止使用加熱器進行回溫)
2. 未回溫即開封使用, 須在開封前用機器攪拌15~20分鐘。(不推薦)
3. 回溫后用機器攪拌以1~3分鐘為宜, 手動攪拌以2~3分鐘為宜。

(轉數視機器型號定, 一般為400rpm. 為防水氣進入, 請避免劇烈攪拌, 同時若攪拌時間過長會由於錫粉之間的磨擦導致發熱, 造成錫膏的惡化。)



● 使用注意事項

1. 將錫膏添加到鋼板上，其量一般控制在滾動徑20-25mm。視生產速度，以少量多次的方法添加鋼板上。
(一般滾動徑接近10mm之前要添加錫膏)
2. 當天未使用完的錫膏在以后還要繼續使用時(使用過一次的錫膏建議廢棄)，不可與未使用的錫膏混放，並蓋緊蓋子放置冷藏庫保管(要求用刮刀刮落容器內壁附有的錫膏，因此部份錫膏在冷藏庫保管時會變干，導致印刷性能降低)，開封過一次未使用的錫膏建議在一周內使用完。
3. 印刷被中斷30分鐘以上場合，需對印刷模板進行清洗並在試印2~3塊後進行生產。(因0.4mm間隔的QFP元件等模板開口部狹小的地方附有的焊膏會逐漸變干，導致印刷模板的脫落性變差。)



● 使用注意事項

4. 第二天使用時, 須將前一天未使用完的錫膏與新錫膏建議以1:2的比例混合使用, 並以少量多次的方法添加于鋼網上.
5. 連續印刷24小時的錫膏因水气和灰塵的污染, 為保證品質須按照上述(4)的方法使用.
6. 要擦拭印刷錯誤的PCB板, 請用IPA進行清洗, 待干燥后用氣槍吹淨.
7. 錫膏工作場所的環境應適合溫度22-28 °C, 濕度30-60%.